

Patice procesoru (Socket) a čipsety

Při výběru základní desky a procesoru musí oba tyto prvky odpovídat dvěma kritériím: fyzickému (patice) a logickému (čipset). Zatímco patice zajišťuje, že procesor do desky fyzicky zapadne, čipset určuje, jak spolu budou komponenty komunikovat.

1. Patice procesoru (Socket)

Patice je mechanický a elektrický konektor na základní desce. Rozděluje se podle způsobu, jakým jsou řešeny kontaktní piny.

Typy konstrukcí

- LGA (Land Grid Array):** Piny jsou umístěny **přímo v patici** na základní desce. Procesor má na spodní straně pouze kontaktní plošky. Tento systém je odolnější při manipulaci s procesorem, ale vyžaduje extrémní opatrnost při montáži do desky. (Používá Intel a nově i AMD AM5).
- PGA (Pin Grid Array):** Piny jsou **na procesoru**. Patice na desce má pouze otvory. Při neopatrné manipulaci hrozí ohnutí pinů na CPU. (Starší platformy AMD, např. AM4).

Aktuální přehled patic (2024-2026)

Výrobce	Patice	Typické procesory	Poznámka
—	—	—	—
AMD	AM4	Ryzen 1000 - 5000	Legendární patice s dlouhou podporou, stále populární pro budget sestavy.
AMD	AM5	Ryzen 7000 - 9000+	Moderní LGA patice, podpora pouze pro DDR5 paměti.
Intel	LGA1700	Core 12., 13. a 14. gen	Hybridní architektura (P-cores a E-cores).
Intel	LGA1851	Core Ultra 200 a novější	Nová patice pro nejnovější generace procesorů.

2. Čipset (Chipset)

Čipset je „mozkem“ základní desky. Je to sada čipů, která řídí komunikaci mezi procesorem, pamětí RAM, grafickou kartou a úložištěm.

Třídy čipsetů (Hierarchie)

Výrobci dělí čipsety do tříd podle výbavy a možností taktování:

A) Základní (H-Intel / A-AMD)

- Příklad:** Intel H610, AMD A620.

- **Určení:** Kancelářská práce, multimédia.
- **Omezení:** Méně USB portů, méně linek PCIe pro rychlé disky, chybí podpora taktování.

B) Střední třída (B-Intel / B-AMD)

- **Příklad:** Intel B760, AMD B650.
- **Určení:** Herní počítače, náročnější domácí uživatelé.
- **Vlastnosti:** Dobrá výbava, u AMD podpora taktování, u Intelu obvykle jen taktování RAM.

C) High-end (Z-Intel / X-AMD)

- **Příklad:** Intel Z790, AMD X670E/X870.
- **Určení:** Nadšenci, tvůrci obsahu, extrémní hráči.
- **Vlastnosti:** Maximální počet PCIe 5.0 linek, nejlepší chlazení napájecí kaskády, plná podpora taktování CPU.

3. Na co si dát pozor při výběru?

DŮLEŽITÉ: Fyzická kompatibilita (stejná patice) nezaručuje automaticky funkčnost. Vždy zkontrolujte **seznam podporovaných CPU** (CPU Support List) na webu výrobce základní desky.

- **Verze BIOSu:** Novější procesory často vyžadují aktualizaci BIOSu u starších desek se stejnou paticí.
- **Napájecí kaskáda (VRM):** Výkonné procesory (i9, Ryzen 9) vyžadují desku s kvalitním chlazením kolem patice, jinak se bude procesor v zátěži podtaktovávat.
- **Generace PCIe:** Levnější čipsety mohou omezovat rychlost moderních SSD disků (např. pouze PCIe 3.0 místo 4.0/5.0).

Navazující články:

- [Procesor \(CPU\) – Podrobný rozbor](#)
- [Operační paměti a jejich frekvence](#)
- [Základy taktování procesoru](#)

From:

<https://serviceit.cz/> - IT ENCYKLOPEDIE

Permanent link:

https://serviceit.cz/doku.php?id=hw:patice_a_cipsety

Last update: **2026/01/13 14:04**

